

dMCS 台式 PXIe 测控系列

HW-1093d(G3)

符合 PXIe/PXI 总线标准规范
国产台式 PXIe 测控平台
支持 19"标准机架式安装
内置厚物科技 PXIe-9180 控制器
内置厚物科技 3U 9 槽 PXIe Gen3.0 高速背板
1 个 3U PXIe 系统槽
7 个 3U PXIe/PXI 混合扩展槽和 1 个 3U PXIe 定时槽
系统槽总带宽 24GB/s
每个扩展槽专用带宽 8GB/s
兼容数采、模块化仪器、航空总线、FPGA 等 PXIe/PXI 模块
主动散热设计
风扇转速可根据机箱内部温度高低实现自动调速
工业设计简洁美观
可实时监控系统电源、风扇、温度状态



动态
视频

HW-1093d方案

业界经典款国产高速高带宽 3U 9 槽 PXIe 台式测控平台

HW-1093d(G3)是业界经典款内置 Intel® Xeon® 八核十六线程 CPU 嵌入式 PXIe 控制器、PXIe Gen3.0 高速背板的标准台式 PXIe 测控平台（支持 19"标准机架式安装），适用于科研试验、自动化测试产线、测试设备台等工作场景。

HW-1093d(G3)内置厚物科技高性能 3U 9 槽 PXIe 高速背板，基于 PCIe Gen3.0 技术，符合 PXIe/PXI 总线标准规范，具有 1 个 PXIe 系统槽、7 个 PXIe/PXI 混合扩展槽（兼容 PXIe 和 PXI 模块）和 1 个 PXIe 定时槽。系统槽总带宽 24GB/s，扩展槽专用带宽 8GB/s，兼容高速数采、高速数字化仪、数字万用表、航空总线、FPGA、射频及开关等 PXIe/PXI 模块。此测控平台为主动式散热设计，支持 PWM 风扇转速控制，根据机箱内部温度高低风扇自适应调整转速对控制器及模块进行散热；具有硬件状态监控功能，可实时监控系统电源、风扇、温度状态。

HW-1093d(G3)充分利用 PXIe/PXI 总线稳定可靠、兼容性好、结构稳固、数据吞吐量大、性能高等特点，根据项目应用不同，此测控平台可内置各种不同的 PXIe/PXI 模块，实现微波射频、高速数字、信号仿真、原型验证、电压电流、温度频率、应力应变、振动冲击、音视频及各种航空总线接口等信号的测试测量，用户可以在此测控平台上快速搭建各种测量、测试及控制系统，适用于军工国防、航空航天、兵器电子、船舶舰载等实战应用场合和科学试验研究场合。

操作系统 Windows® 7 Professional
Windows® 10 Professional

处理器 Intel® Xeon® Processor D-1548 2.0GHz (12M Cache, up to 2.6 GHz) 八核十六线程

独立显卡 NVIDIA GeForce GT 1030 GDDR 2GB (选项 1)
NVIDIA GeForce GTX 1050 GDDR 2GB (选项 2)

内存 16GB DDR4 (可升级为 32GB/48GB)

存储 SATA 1TB SSD (可升级为 2TB)

链路配置 配套控制器
PCIe Gen3.0 规范
2 Link 模式: PCIe3.0 x16 + PCIe3.0 x8

深圳市厚物科技有限公司

SHENZHEN HOUWU TECHNOLOGY CO., LTD.

深圳市宝安区松岗芙蓉路 9 号桃花源科技创新园 B 栋四楼

0755-29982022

houwu.com.cn

背板	3U 9 槽 PXIe 背板，基于 PCIe Gen3.0 技术 1 个 PXIe 系统槽、7 个 PXIe/PXI 混合扩展槽和 1 个 PXIe 定时槽 系统槽带宽 24GB/s，8 个扩展槽带宽均为 8GB/s
IO 接口	LAN x2，USB3.0 x4，USB2.0 x2，RS232 x2，DP x2，SMB x1，LED x2
散热	风扇支持 PWM 工作模式，自适应调速，主动散热，符合 PXIe/PXI 总线标准规范
电源	500W，工业级，110~220VAC 输入
环境	工作温度： 0°C ~ 50°C（常温级） 工作温度： -10°C ~ 55°C（工业级） 存储温度： -40°C ~ 70°C 相对湿度： 5% ~ 95%（无凝露）
抗冲击	30G 峰值，半正弦，11ms 脉冲
抗振动	2.4Grms@5~500Hz（X、Y、Z 三方向各 1 小时）
尺寸	302 x 422 x 177 mm（不含把手及支撑脚）
重量	10.3KG（含厚物科技 PXIe-9180 控制器）
包装	定制配套包材
类型	dMCS 台式 PXIe 测控系列

注意：由于产品定期升级，如需更准确的规格配置信息，请联系厚物科技 0755-29982022